联络人
投资人关系
+886 3397 5999 ext. 1204
ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2022 年第一季自结财务报告

2022 年 4 月 28 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(28)日公告 2022 年第一季自结财务报告。

2022 年第一季财务概况

- 本季合并营收新台币 55.97 亿元，较前季减少 22%，较去年同期减少 7%
- 本季合并毛利率为 30.6%，较前季减少 9.9 个百分点；本季营业净利率为 16.4%，较前季减少 11.4 个百分点
- 本季营业净利为新台币 9.16 亿元，较前季减少 54%，较去年同期减少 23%
- 本季税后净利为新台币 7.86 亿元，较前季减少 53%，较去年同期减少 28%；每股盈余为新台币 2.08 元，前季为新台币 4.19 元

2022 年第二季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- 第二季营收预计较前一季下滑 high-single digit 百分比。
- 第二季毛利率预计约落在 high-twenties 至 low-thirties 区间的水平。

免责声明
本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

管理者评论

*“在历经去年第四季单季营收历史新高之后，**2022**年第一季在面临传统淡季及智能型手机产业库存调整的逆风之下，营收为新台币**55.97**亿元，季成长率及年成长率分别为**-22%**及**-7%**。虽然产品组合并未更差，但是受到产能利用率自上一季的**100%**下滑到**70%**的影响之下，营业毛利率及营业净利率也因此分别下降到**30.6%**及**16.4%**的水平，第一季**EPS**为新台币**2.08**元。*

*综观第一季产品组合中，**3D**感测的需求在经过去年第三、四季的新品备货旺季之后，如之前预期的进入淡季，是季减最为明显的产品。其次是以中国智能型手机为主的**Cellular PA**以及**Wi-Fi PA**，都受到终端库存过高的影响，营收自高点滑落。最后，毛利较佳的基础建设及卫星相关出货则是下滑幅度不若手机相关应用的明显。虽然近期产业遭遇乱流，造成短期需求透明度不高，但是我们对于产业中长期的成长动能看法不变，尤其是**5G**在智能型手机的持续渗透及**5G**基础建设含低轨卫星的发展，**Wi-Fi 6/6E**到**Wi-Fi7**的演进，以及日益吃重的光通讯、光感测业务等等的长期需求之下，稳懋的南科路竹厂建厂工程预计**2~3**年后加入量产进度不变，至于短期去瓶颈化的产能扩充则采动态调整因应产业变动。*

*展望第二季，持续受到中国智能型手机库存调整的影响下，营收预计将较前一季下滑**high-single digit**百分比，毛利率预计落在**high-twenties**至**low-thirties**区间的水平。"*

关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英吋晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。